CARTA DE INVITACIÓN

Señores

OFERENTES

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar en el procedimiento a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS "ADQUISICIÓN DE KIT PARA SISTEMA DE CONEXIÓN PISO Y PARED DE ½" - ID: 436.165.**

La oferta deberá ajustarse a las condiciones y plazos del presente procedimiento de contratación, establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan en el SICP.

Atentamente.

Lic. Emilce D. Lovera
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.